



SP-RC

PLASMA TREATMENT ENTRY MODEL

Xử lý khí plasma là công nghệ đặc biệt dùng để xử lý bề mặt trong quy trình lắp ráp điện tử như: Làm sạch nano, loại bỏ chất bẩn hữu cơ, Hàn gắn/sửa chữa bề mặt, cắt và khắc bề mặt, xử lý kháng nước, dính nước, thụ động, tương thích sinh học và plasma cho hầu hết các vật liệu như composites, nhựa, kim loại, kính, cát tông, vải... Với công nghệ plasma của Anda, máy xử lý plasma bề mặt có thể đưa vào dây chuyền phủ bảo vệ phù hợp có chọn lọc và phân bổ chất lỏng.

Khi plasma được tạo ra dưới điện áp cao (15 ~ 20kV) sẽ xả ra môi trường một tia plasma thổi hoặc bắn vào các đầu nối mà chúng có thể tiếp xúc với các tổ hợp điện tử gây hỏng hóc đối với các linh kiện điện tử nhạy cảm. Với xử lý plasma Anda tạo ra vòng kín hấp thụ dòng điện để loại bỏ điện áp cao bắn vào khoang xả và xử lý an toàn cho các linh kiện nhạy cảm.

Các thông số kỹ thuật máy xử lý plasma SP-RC

Kích thước tổng thể:	1200 x 1000 x 1600mm
Trọng lượng tổng thể:	500KG
Giao diện người dùng:	Windows PC or PLC + Touch Panel
Giàn X/Y:	Mô tơ bước + Đại đồng bộ
Dải làm việc:	450 x 450mm
Khoảng cách vận hành:	3 ~ 15mm
Tốc độ vận hành:	20 ~ 200mm
Công suất:	230VAC 50/60Hz
Đầu plasma:	Xoay hoặc phun

Các tính năng tiêu chuẩn

- Đầu xoay hoặc phun
- Màn hình cảm ứng hoặc điều khiển bằng máy tính
- Dừng PCB
- Ổn áp và nguồn dự phòng
- Điểm nối đất an toàn tĩnh điện
- Theo tiêu chuẩn CE

Các tính năng trang bị thêm

- Băng chuyền tải trọng cao
- Hệ thống băng chuyền kép
- Băng chuyền 2 trạng thái
- Camera trực quan CCD
- Băng chuyền đưa pallet quay về (phía dưới)
- Hệ thống quét mã vạch hoặc mã 2D

